

FX16- FLUSSANTE NO CLEAN

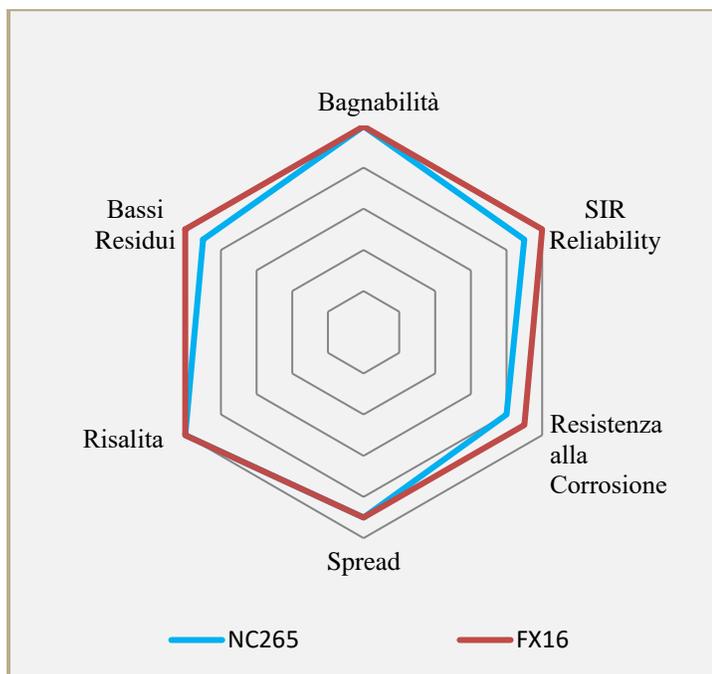
CARATTERISTICHE

- Completamente esente da alogeni
- ROL0 Per IPC J-STD-004A/B
- Lassi residui post processo
- Massima bagnabilità con leghe leadfree e con piombo
- Conforme a IPC-A-610F
- Massimi risultati SIR
- Ampia finestra di processo

DESCRIZIONE

Il flussante no clean FX 16 è stato formulato per ottenere grande performance di saldatura lasciando al tempo stesso minimi residui, elettricamente sicuri anche in assenza di preriscaldamento. FX16 è ideale per saldature selettive e per saldature ad onda. FX16 offre grande bagnabilità e risalita sui PTH e riduce i difetti di saldatura più comuni come corti, ponti e solder balls. FX16 ha un sistema di attivatori resistenti ai processi ad alta temperatura anche con elevati tempi di contatto.

CARATTERISTICHE



MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Parametro	Tempo	Temperatura
Sigillato	1 anno	Temperatura ambiente

FX16 ha una scadenza di un (1) anno se stoccato a temperatura ambiente. Tenere lontano da fiamme e dalla luce diretta del sole, che potrebbe degradare il prodotto. FX16 è fornito pronto all'uso, non è necessaria diluizione. Non mischiare prodotto nuovo ed usato nello stesso contenitore. Conservare a temperatura compresa fra 4-40°C

APPLICAZIONE

FX16 è formulato per applicazione a spray, con pennello o ad immersione. FX16 è pronto all'uso appena aperto, non è necessaria la diluizione. Se nebulizzato, è imperativo che si raggiunga un'adeguata e costante patina di flusso. Una pellicola di flusso a secco di 140-235 microgrammi per centimetro quadrato è ideale.

LINEE GUIDA DI PROCESSO

Controllare con la termocoppia che il lato top del PCB abbia una temperatura compresa fra 80-140°C. È importante che il flusso sia asciutto quanto va a contatto con l'onda per evitare schizzi. Se non eccessivo, il fumo prodotto è normale. Il tempo ideale di contatto con l'onda dipende dalla configurazione della stessa, dalla temperatura del pozzetto, tipo di lega e massa termica, ma si ritiene che un tempo di 3-7 secondi sia tipico per applicazioni leadfree. Per assistenza sul processo, si invita a contattare il Supporto Tecnico AIM, visitando <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts>.

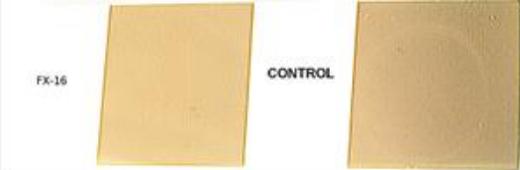
LAVAGGIO

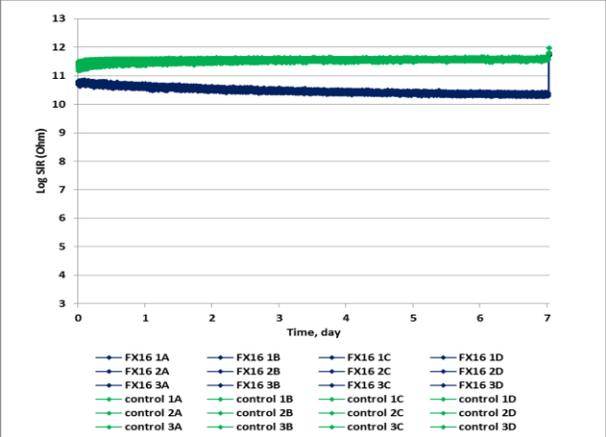
I residui possono rimanere e non richiedono il lavaggio . Laddove ne fosse obbligatoria la rimozione, AIM ha collaborato con i principali produttori di solventi per sviluppare prodotti efficaci e sicuri. Contattare AIM per la compatibilità dei diversi prodotti sul mercato.

SICUREZZA

Usare con adeguata ventilazione e idonei dispositivi di protezione individuali. Riferirsi alla scheda di sicurezza per specifiche informazioni in caso di emergenza. Non smaltire il prodotto usato in contenitori non appropriati

DATI RIASSUNTIVI DEI TEST

Nome	Metodo	Risultati	
Classificazione flusso IPC	J-STD-004	ROLO	
Classificazione flusso IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROLO	
Nome	Metodo	Risultati	Immagine
Copper Mirror	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BASSO	
Corrosion	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASSA	
Quantitativo alogeni	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.00% Cl: 0.00%	
Qualitativo alogeni, Silver Chromate	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASSA	
Qualitativo alogeni, Fluoride Spot	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No Fluoruri	

Nome	Metodo	Risultati	Immagine
SIR	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	tutte le misurazioni su tutti i test pattern eccedono i 100MΩ	
Determinazione dei solidi non volatili	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	2.7 Tipico	
Determinazione valore acido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	16.0 Tipico	
Determinazione densità	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.80 Tipico	
pH (1% soluzione /acqua)	ASTM D5464 ASTM G51	5.26 Tipico	
Visivo	J-STD-004B 3.4.2.5	PASSA	
Wetting	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASS	